

2005 IECQ-CECC 국제회의

디지털연구사 구창환
02) 509-7267 kooch@ats.go.kr

1. 출장개요

- 목 적 : 2005년 IECQ-CECC 전자부품 품질인증 회의 참가
- 출장기간 : 2005. 4. 4(월) ~ 4. 9(토)
- 회의장소 : 영국, 런던 BSI-ps
(영국표준협회 product.service)
- 참가자 : 10개국 28여명
- 한국(2), 중국(5), 일본(1), 영국(4), 프랑스(1), 오스트리아(1), 미국(3), 독일(1), 대만(3), 러시아(2) 외 중앙사무국(3)
- 출장자
기술표준원 디지털표준과 연구사 구창환
산업기술시험원 품질인증본부 선 임 이기석
- 수행업무

2. 주요 회의 내용

- 가. 적합성평가위원회(CABC)
 - 일시 : 2005 04. 06 (수) 오전 9 : 00 ~ 12 : 25
 - 감독검사기관(SI)의 심사결과
 - 2004년 감독검사기관심사결과, 사후관리 진행상황 및 2005년 심사계획에 대해 의장인 R. Moore가 발표
 - 신규 SI인 미국 DNV에 대한 영국 BSI의 심사결과, 기준에 적합하여 금년부터 SI 업무수행을 인정함.
 - 프랑스 LCIE 및 독일 VDE에 대한 사후관리심사결과 기준에 적합하여 재승인.
 - 인도 STQC에 대한 중국 CEPREI의 사후관리 심사결과 기준에 만족하나 분담금지급문제 및 문서상 보완여부에 따라 추후 재승인 결정

소 속	성 명	수행업무	비고
기술표준원 디지털표준과	구창환 연구사	· IEC 국가 대표 활동 · 신규 운영위의 창설 배경과약 · CECC와 통합이후 국제동향 및 활성화	비고국가 대표기관 (NAI)
산업기술시험원	이기석 선 임	· 부품의 시험방법 인증시험 토의 · 각국의 IECQ 인증 실적 파악	감독 검사기관 (SI)

○ 기타 감독검사기관 주요 심사일정

SI	SI실사일	심사국	심사예정	비고
BSI PS(영국)	2000-03		2006	-
GOSSTANDART (러시아연방)	2000-11/12		2005	-
OVE(오스트리아)	2002		2007	-
RC(일본)	2002-10		2007	승인
KTL(한국)	2004-01		2009	승인
CEPRE(중국)	2004-02		2009	승인
LCIE/SNQ(프랑스)	2004-07-21/22		2009	승인예정
VDE(독일)	2004-10-12/13		2009	승인예정
STQC(인도)	2004-12-16/17	중국	2009	분담금 지급문제
DNV(미국)	2004-04	영국	2009	ECCB Pilot제도 적용
NSAI(미국)	2004-04	영국	2009	ECCB Pilot제도 적용

□ 미국 NAI의 시범프로그램(pilot program) 운영 결과보고

- 미국의 NAI인 ECCB는 자국내 3개 인증기관(DNV, NSAI, KEMA)을 SI로 지정코자 하였으나 KEMA는 지정을 거부함.
(따라서, DNV, NSAI만이 SI로 활동예정)
※ Pilot Program

- 미국 NAI에서 운영하여온 품질시스템 제도인 IAF/AB체도를 IECQ에서 인정하여 줄 것을 제안

- 항공전자부품에 대한 전자부품관리계획(Electronic Components Management Plan)의 적용
- 미국 ECCB는 항공전자부품의 수입 시 전자부품관리계획(ECMP) 시스템을 적용할 것임을 제안

- 현재 미국 및 유럽지역의 항공업체가 요구하는 제품 및 품질시스템규격이 복잡하여 국내 기업의 수

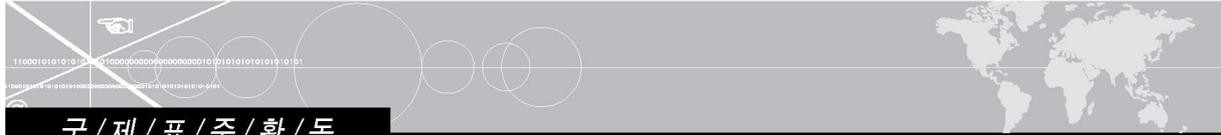
출이 전무

○ 전자부품관리계획 이용시 국내기업 활용용이

- 위험물질처리제도(Hazardous Substances Process Management)가 무연조건과 함께 2006년 7월부터 유럽전역에 공식적용
- 우리나라업체는 환경규제에 대비하여 이에 대응하고 있음

- 인터넷 베이스 인증관리시스템개발 및 사용
- IECQ인증제도의 효율적인 운영과 관리체계구축이 목적.(인증 및 인증결과, 등록 등의 업무를 인터넷망을 통하여 하는 제도로 2004년 5월부터 시행 중.)
- 미국의 항공업공동체는 수입하고 있는 반도체 부품의 신뢰성 평가 및 품질관리현황을 신속히 확인할 수 있기를 희망 (본 시스템 이용가능)

□ CECC마크의 사용현황



국/제/표/준/활/동

○ 마크발행현황

- BSI(영국), LCIE(프랑스), VDE(독일)의 3개 인증기관

○ 대만은 CECC마크 인증을 미국의 SI를 통해 받고 있음.

□ IEC와 ILAC의 상호양해각서(MOU) 체결

○ IEC와 ILAC이 ISO/IEC 17025 분야에 대해 각각의 인정체도의 운영절차에 대한 MOU체결.

○ 상호인정되는 회원의 시스템 : 32개국

국가	제도	국가	제도
Chinese Taipei	CNLA/TAF	France	COFRAC
Finland	FINAS	Indonesia	KAN
United Kingdom	UKAS	Israel	ISRAC
Hong Kong	HKAS	Singapore	SAC
Netherlands	RvA	New Zealand	IANZ
Romania	RENAR	China	CNAL
Norway	NA	Malaysia	DSM
Korea	KOLAS	Thailand	TLAS
Switzerland	SAS	USA	A2LA
Greece	ESYD	Japan	IJapan
Vietnam	VILAS	Slovakia	SNAS
Ireland	INAB	Czech Republic	CAI
Australia	NATA	USA	IAS
Slovenia	SA	India	NABL
Japan	JAB	Belgium	BELAC (BELTEST)
South Africa	SANAS	Germany	DATech

나. MC 위원회 회의결과

- 일시 : 2005.04.06 (수) 오후 14 : 00 ~ 18 : 00
2005.04.07 (목) 오전 09 : 00 ~ 15 : 00

□ Membership변경

- 간사 : Mr. R. Kay(IECQ간사)
 - 현재 간사인 Kay는 정년으로 2006년 9월 30까지 임기.
 - 차기 간사를 IEC 사무국직원 중 돌색 중

- 재무담당 J Chapman(ECCB)
 - J. Chapman은 2004년 12월로 임기완료.
 - 유임예정

□ IECQ 브랜드 이미지 개선

- IECQ-CECC를 IECQ로 환원키로 함.
 - 새로운 명칭인 IECQ-CECC가 익숙치 아니하여 기존의 명칭을 다시 쓰기로 결정.
- 2005년 인증건수를 각 기관별로 25% 향상.
 - 제도의 활성화를 위하여 각 기관별로 인증실적을 향상시키기로 함.
 - 전자부품관리계획, 위험물질처리제도의 인증 실적 확대필요

□ 2005년 재정결과보고

- IECQ의 2005년도 예산은 2004년도와 동일하게 책정. (한국 : 6,200CHF)
- 2006년도 재정 및 예산은 금번 회의에서 잠정결정하고 올해 IEC총회(CAB)를 통해 최종결정.

- 교육비 분담
 - 전자부품관리제도(ECMP) 및 위험물질처리제도(HSPM)를 운영 하고자 하는 기관은 사무국으로 교육비 지불해야함

□ 운영위원회(Executive Board) 창설

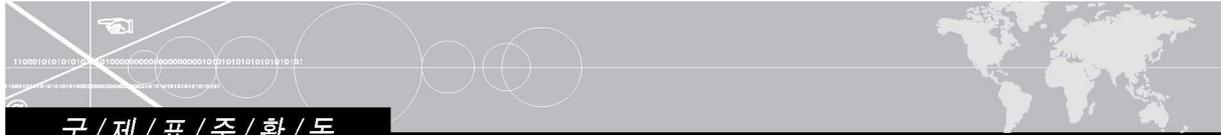
- 설립목적
 - 행정업무를 신속하게 처리하기 위하여, 제시된 의견 및 기타안건을 결정하는 업무전담
- 위원선정 및 의견수렴작업에 대해 좀더 검토가 필요 (관리위원회 의장)
 - 운영위원회의 설치는 2006년 차기회의에 결정하기로 함.

- 임원구성
 - NAI 임원 6명을 선정하여 운영위원회를 구성.
 - 운영위원회의 위원의 활동임기는 3. 2. 1년이며, 개인의 경력을 위주로 선정.

- 위원회는 최소 1년에 3회 이상 의장과 함께 회의를 갖으며, 전자메일 및 그 밖의 전자통신수단을 이용가능.

- 안전에 대한 결정은 2/3이상의 찬성으로 가능하며 3표 이하의 표를 득한 안건은 다음회의에서 재투표하기로 함.

- 역할
 - 제도규정의 운영
 - 관리위원회(MC)회의일정 결정 및 관련문서 작성
 - 적합성평가위원회(CABC)로부터의 보고내용 관리
 - Working Group의 구성
 - Working Group의 의장 및 회원 선정



국/제/표/준/활/동

- Working Group으로부터의 보고내용 접수 등

이유는 부품자체조달이 가능하며, 수요업체에 종속되어 있기 때문.

그 기타

○ Mr. Johathan Buck(Head of communications and marketing, IEC 중앙사무국)의 Executive MBA 프로그램(Business School of Lausanne, 스위스)에서 IECQ의 통합 및 신규사업개발과 관련한 자문 등의 내용을 다룸에 따라 직접 회원들에게 발표.

○ 주요내용은 IECQ의 Brand이미지를 강화하고 이를 통한 산업계로의 IECQ인증제도의 홍보를 강화해야함을 강조.

3. 관찰 및 평가

○ 미국측은 IECQ를 활성화시키기 위해 다양한 시범프로그램을 직접 운용

○ 국제회의 참가효과를 최대한 올리기 위해서는 관련지식의 숙지, 능숙한 영어, IECQ 관련 인사들 간에 유대관계의 유지가 필요함.

○ 미국의 항공산업계는 환경관련 규제에 대해 민감한 반응을 보이는 것으로 파악.

- 항공전자부품에서의 신뢰성에 끼칠 영향에 대해 염려.

○ 전자부품인증제도의 활용성이 상대적으로 낮은

4. 차기 회의일정 및 장소 결의

○ 장소 : 미국 샌프란시스코

○ 시기 : 2005년 5월 2째주

○ 북미지역 해외 전자부품기업들에게 IECQ의 인증제도 및 미국이 IECQ인증제도의 활성화를 위해 추진하고 있는 시범프로그램에 대한 설명회를 개최할 예정

5. 종합 의견

○ 제도의 활성화를 위해 미국측에서 많은 시범프로그램을 추진 중이며, 특히 항공전자부품분야에 대하여 보잉측에서 관심이 많았음.

○ 미국의 NAI가 제시한 인터넷 인증관리시스템의 구축으로 세계의 우수한 기업들에 대한 IECQ제도 홍보가 용이해질 것으로 예상되며 이에 따른 IECQ인증을 획득한 기업에게 직접적으로 이익을 가져다 줄 것을 기대.

○ 내년 회의에서는 한국의 부품수요업체들을 참석시켜, IECQ의 인증제도에 대해 홍보하고, 국내 부품업체들이 항공전자부품분야에 진출 할 수 있도록 도움을 줄 수 있도록 함 **결론**